

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函[478号]的回复

### 特别提示:

1. 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已经确定了向半导体芯片领域转型的方向，当前主要业务贡献仍来自于电子元器件分销业务，公司当前进入半导体芯片领域的研发团队及技术储备主要依靠收购的英唐微技术有限公司（以下简称“英唐微技术”）和即将参股的上海芯石半导体股份有限公司（以下简称“上海芯石”），公司对英唐微技术的产品线改造还在逐步落实过程中，且其尚未恢复盈利，存在未来经营业绩及改造进度不及预期的风险；参股上海芯石，公司尚未与交易对手方签署正式协议，最终参股比例及交易价格等交易事项还未最终确定，存在不确定性；

2. 目前国内碳化硅市场仍在逐步发展过程中，整体市场规模并不大，且产业链各环节所需原材料仍然对国外依赖性较高；国内半导体企业在产能规模、解决方案及品牌信任度等方面，与国际企业相比存在着差距。公司开发的碳化硅器件产品大规模商业化何时启动及市场需求大小、产线改造完成时间尚存在不确定性，因此公司在该领域的未来发展存在一定的不确定性；

3. 英唐微技术所拥有的 5 台光刻机，是其为满足自身业务开展的需要于早期对外购置的日本尼康设备，其主要为 0.35 $\mu\text{m}$  制程的技术指标满足英唐微技术现有或规划产品的需要，英唐微技术本身不涉及光刻机设备的研发制造业务；

4. 公司 2020 年前三季度扣非后净利润为-23,942.51 万元，同比下降 282.98%。公司于 2020 年 9 月完成了对联合创泰 100% 股权的出售，其营业收入占公司营业收入的比重较大，公司短期内营业收入将出现较大幅度的下降，联合创泰剥离后，其拥有的海力士、联发科等代理产品线资源也将从公司剥离；

5. 公司控股股东胡庆周先生目前质押股份总数 205,516,563 股，其中 48,715,063 股股份处于逾期状态；其于 2020 年 8 月 21 日披露了股票减持计划，详见《关于公司控股股东股份减持预披露的公告》（公告编号：2020-093），胡庆周先生为偿还质押贷款，计划自 2020 年 9 月 14 日至 2021 年 3 月 14 日期间以集中竞价交易、大宗交易或协议转让的方式减持本公司股份，减持总数不超过 53,260,680 股，占本公司总股本比例 4.98%；

6. 公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，应当审慎决策、理性投资。

**深圳证券交易所创业板公司管理部：**

根据贵所于 2020 年 10 月 22 日下发的《关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2020】第 478 号）（以下简称“关注函”），公司管理层高度重视，对关注函中涉及的问题进行了认真核实，现将相关情况说明如下：

一、请你公司补充说明对英唐微技术生产线进行升级最终形成 SiC 器件产能涉及的主要工作环节、难点及解决方案、最新进展、已投入的资源、尚需投入的资源、改造完成后的产能、产品及应用范围与现有产品的异同、在手订单情况，公司判断完成升级改造和形成产能时间的依据及合理性，相关产线改造是否会对公司 2020 年经营业绩产生重大影响，并充分提示风险。

**【回复】**

英唐微技术目前具有的 6 英寸硅基晶圆生产线，月产能在 6000 片晶圆左右，主要应用于硅基芯片产品，此前未涉足 SiC 相关器件的生产。在对现有产线进行升级改造后，包括但不限于加装高温离子注入、栅极氧化等多种工艺设备后，可以使得原有硅基生产线兼容生产具有高温、高频、抗干扰特性的 SiC 器件产品的能力。本次改造将分期进行，首期改造将形成 SiC 器件月产能约 2000 片晶圆（整体改造后产能规模属于行业中等水平，具体生产器件数量将根据改造完成后产线性能及器件产品的设计指标最终确定），保留原有硅基器件月产能 4000 片，后期改造将视业务发展情况适时展开。

其改造的主要工作环节包括：改造方案评估、设备选型购买、设备安装、工艺调试等，其难点在于工艺的调试，要使得整条生产线达到满足半导体芯片批量化生产所需的精密度和稳定性，要对改造新增的单项工艺以及整条产线的串线工序进行反复调试，直至产线的良品率满足设计要求，这是一个需要具有丰富改造经验的专业团队并耗费大量时间的不断磨合过程，英唐微技术董事长张远先生及其团队曾多次完成半导体生产线的建立、转移、升级项目，公司可以借助其丰富的实践经验和行业资源推进英唐微技术生产线改造升级项目的顺利完成，但 SiC 生产线毕竟属于新的技术，能否实现改造工程的按期完成存在一定的不确定性。

截止目前，公司除通过收购英唐微技术 100% 股权获得了产线外，还完成了

首期产线改造的评估、设备选型及技术支持团队组建的等前期工作，并正在与英唐微技术管理层及生产制造部门进行交割后的深入对接，讨论组建负责设备购买及后期安装调试等具体工作的专项工作组，待对接工作完成后再逐步投入改造资金，整个首期改造升级计划所需资金预计在 6000-8000 万人民币左右。本次改造预计耗时最长不超过 12 个月，其中设备的交付安装预计耗时 3-6 个月，主要原因在于设备供应商的交货周期较长；产线的单项工艺调试、串线调试到形成产能预计耗时在 3-6 个月左右，主要视于新老设备工艺的匹配程度、调试人员的经验丰富程度有所不同，参考国内同类产线平均 2-3 年的建设达产周期，改造升级存在投入较小、周期较短的优点。

本次改造前，英唐微技术生产线主要用于其原有车载芯片、OEIC、LCD、光学传感器产品的生产。改造完成后，除上述产品外，还将兼备以 SiC-SBD 为主的第三代半导体功率器件的生产，并在持续升级设备和工艺后，逐渐拓展至其他的第三代半导体产品。传统 Si-SBD 是一种低功耗、超高速半导体器件，广泛应用涉及变频器、开关电源、驱动器等电路，在电源，充电器，适配器、汽车电子、小家电行业等均大量使用。比硅基器件，SiC-SBD 功率器件主要有三大优势：耐高温、高压；器件小型化和轻量化；低损耗、高频率。碳化硅 SBD 对应于硅基快恢复二极管（FRD），相比硅 FRD，碳化硅 SBD 具有更低的恢复损耗、更高的开关频率和运行温度，同时拥有近乎理想的反向恢复特性，可以显著降低电路的损耗，提高运行频率，实现器件小型化，在新能源汽车、风力发电、太阳能光伏、电机驱动以及直流充电等领域有着广阔的潜在市场。但目前尚处于初步应用阶段，制造成本较高，整体市场规模偏小。

依托上海芯石的技术和人才储备，公司已经实现了 SiC-SBD（600V、1200V、1700V、3300V）的产品研发设计，通过代工厂进行流片试制，并已经进入客户的样品验证阶段，目前暂未获得正式批量订单及实现销售。未来公司的 SiC 器件流片、大批量制造工作将由产线改造升级完成后的英唐微技术进行承接。

英唐微技术本次 SiC 产线改造到产能释放耗时较长，预计将在 2021 年完成，因此不会对公司 2020 年业绩产生重大影响。尽管公司已经为后续改造做了较为充分的准备，但受设备交付周期、工艺调试以及人员磨合的影响，产线改造完成并实现产能的释放的具体时间仍具有不确定性，同时，公司目前 SiC 产品还处于

客户试样阶段，尚未通过客户的最终认证并获得正式批量生产的订单，且短期内形成的销售规模预计较小，对公司业绩的贡献存在不确定性，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

二、请结合 SiC 产品和技术在国内外的研发、应用现状、市场规模、竞争格局以及公司在相关领域的研发投入、专利技术及人才资金储备情况说明你公司是否具备开展相关业务的核心竞争力。若是，请说明具体情况。

### 【回复】

SiC 材料由于具有禁带宽度大、热导率高、电子饱和迁移速率高和击穿电场高等性质，SiC 器件在高温、高压、高频、大功率电子器件领域和航天、军工、核能等极端环境应用领域有着不可替代的优势，弥补了传统半导体材料器件在实际应用中的缺陷，正逐渐成为功率半导体的主流。

IHS 预计未来 5-10 年 SiC 器件复合增速 40%:根据 IHSMarkit 数据,2018 年碳化硅功率器件市场规模约 3.9 亿美元,受新能源汽车庞大需求的驱动,以及光伏风电和充电桩等领域对于效率和功耗要求提升,预计到 2027 年碳化硅功率器件的市场规模将超过 100 亿美元,2018-2027 年 9 年的复合增速接近 40%。

SiC 的产业链主要由单晶衬底(主流为 4-6 英寸)、外延、器件、制造和封测等环节构成。从产业格局看,目前全球 SiC 产业格局呈现美国、欧洲、日本三足鼎立态势。其中美国全球独大,占有全球 SiC 产量的 70%~80%,碳化硅晶圆市场 CREE 一家市占率高达 6 成之多;欧洲拥有完整的 SiC 衬底、外延、器件以及应用产业链,在全球电力电子市场拥有强大的话语权;日本是设备和器件模块开发方面的绝对领先者。

公司未来的重点主要集中在碳化硅功率器件的设计、生产环节,在这一领域国内也有部分企业开始布局生产,但国内的企业均处于初创期或者刚刚介入 SiC 领域,包括传统的功率器件厂商华润微、捷捷微电、扬杰科技,从传统的硅基 MOSFET、晶闸管、二极管等切入 SiC 领域,IGBT 厂商斯达半导、比亚迪半导体等,但国内当前的 SiC 器件营收规模都比较小,市场潜力巨大。

截止目前,公司及原有子公司在 SiC 功率器件领域暂未进行研发投入,未来主要的研发力量将来自即将参股的上海芯石、已经收购的英唐微技术以及公司自建的研发团队和技术储备,其中即将参股的上海芯石是半导体国内领先的分立器

件研发、设计与销售企业，以其子公司上海芯石微电子有限公司为基础，在半导体分立器件芯片尤其是肖特基二极管芯片领域具有十几年的技术储备及行业经验，目前业务产品主要覆盖两大类：Si 类（SBD、FRED、MOSFET、IGBT、ESD 等功率芯片产品）、SiC 类：（SiC-SBD、SiC-MOSFET）。

在研发投入和技术方面，上海芯石 2018-2019 年分别实现销售收入 4,692.64 万元、3,380.73 万元，研发投入分别为 339.35 万元，328.35 万元，其中在 SiC 器件研发上投入分别为 164.86 万元，252.35 万元，上海芯石还引入了多名具备丰富学术理论知识和国际产业经验的顾问，并和国内高校的 SiC 团队达成了技术合作。在此基础上，上海芯石已完成 6 项上海市高新技术成果转化项目，还分别形成了与产品性能密切相关的 IP 共计 63 项，其中 SiC 产品领域目前形成了 2 项实用新型专利、2 项集成电路布图，1 项发明专利（实审），具体情况如下：

IP 名称	发布号	类型	状态
一种具有复合沟槽结构的碳化硅肖特基器件及其制造方法	201811560544.8	发明	实审
一种具有复合沟槽结构的碳化硅肖特基器件	201822141424.6	实用新型	授权
一种耐用的碳化硅肖特基二极管	201920378123.7	实用新型	授权
三相全桥 SiCMOS 驱动芯片	BS. 205545882	集成电路布图	授权
双相全桥 SiCMOS 驱动芯片	BS. 205545890	集成电路布图	授权

在 SiC 功率器件领域，上海芯石已经成功开发了 600V、1200V、1700V、3300V 的 SiC-SBD 产品，而当前市场主流产品集中在 1700V 以下，超过 1700V 的本土高压高频高功率器件并不多见，目前上海芯石已经实现了部分 SiC 型号产品的小批量量产，2020 年初至今已实现同类产品的销售收入约 500 万元。

在生产制造方面，英唐微技术现有生产线第一阶段改造完成后，公司将拥有完全自主的 SiC 器件生产能力，可做到产品设计、制造、检测、交付的高度统一配合，有利于实现制造过程的降本增效，提升公司产品的市场竞争能力。

在市场拓展方面，我国是碳化硅最大的应用市场。LED 照明、高压电力传输、家电领域、5G 通信、新能源汽车，这些碳化硅和其他三代半导体的核心应用场景，都以我国作为最大主场。全球生产的碳化硅器件，50%左右就在我国消耗。公司作为具有 20 多年行业经验的电子元器件分销商，在上述领域积累丰富的客户资源，随着 SiC 产品逐渐的大规模应用，公司将有望凭借自身的资源优势，快

速打开市场。

通过出售资产，公司获取了较为充裕的现金储备，可以满足公司在转型初期的资金需求。未来，公司不排除继续通过各种再融资方式筹集资金满足公司在产品研发、业务拓展方面的资金需求。

综上所述，针对 SIC 产品领域，公司在技术、研发团队、生产制造、市场拓展及资金储备均已有了有一定基础或者规划，具备开展业务的核心竞争能力。但目前国内碳化硅市场仍在逐步发展过程中，整体市场规模并不大，且产业链各环节所需原材料仍然对国外依赖性较高；国内半导体企业在产能规模、解决方案及品牌信任度等方面，与国际企业相比存在着差距。公司开发的碳化硅器件产品大规模商业化何时启动及市场需求大小、产线改造完成时间尚存在不确定性，因此公司在该领域的未来发展存在一定的不确定性；

三、请补充说明英唐微技术新能源汽车车载 IC 产品的情况，包括但不限于相关产品名称、市场竞争格局、市场地位、收入和利润金额及占整体收入和利润的比重等。结合新能源汽车厂商对不同产品的认证和供应商遴选机制等说明快速扩大英唐微技术业务的可行性，并充分提示风险。

**【回复】**

目前英唐微技术在车载领域产品主要包括数字电视信号接收 IC、BUS-IC、汽车诊断 IC（GNSS 和 V2X 系统线路连接状态检测）以及其他器件产品等，均适用于传统燃油汽车和新能源汽车，具体情况如下：

车载芯片/产品名称	产品功能	生产状态	应用场景
车用 BUS 驱动器/接收器 IC	车辆信号设备之间的信号发送、接收控制	量产	导航系统， 车载视频接收器、后座显示器、安全摄像头、平视显示器等车载设备（传统/新能源）
电压监测 IC	车辆设备供电电压的监控预警	量产	
看门狗定时器和复位 IC	监控车辆设备中的微型计算机的运行，并通过复位防止失控	量产	
视频隔离放大器 IC	消除视频信号传输路径噪声的放大器	量产	
视/音频选择器 IC	多个视频、音频信号的选择控制，适用于处理多种视频媒体的设备	量产	
GPS 天线诊断 IC	诊断 GPS 及 V2X 天线连接状态，并为天线供电	量产	
MEMS 工艺类产品	微电子机械系统	量产	无人驾驶
SiC-SBD	低压、大电流输出场合用作高频整流	规划	新能源汽车

基于英唐微技术的独创的高精度传输线特性估计算法，在多径干扰、衰落或多普勒频移等恶劣环境下，实现了卓越的汽车高速移动过程中信号稳定接收性能，其数字电视信号接收 IC 在日本汽车同类市场上占有率已经达到 50%。根据英唐微技术 2019 财年数据显示，其车载 IC 实现销售收入为 18.73 亿日元（未对来自燃油汽车/新能源汽车领域的销售收入做单独区分），占销售总额比例为 35.9%，实现毛利 2.86 亿日元，占总毛利比例为 66.28%。

一般情况下，汽车厂商对旗下汽车零部件的认证过程长达 2-3 年，新能源汽车也不例外。但公司原主营业务为电子元器件分销商，积累大批汽车及汽车零配件厂商，诸如德赛、华阳、好帮手、飞歌、长河、广汽、长城、吉利、北汽、长安等客户资源，具备良好的合作关系；且英唐微技术汽车 IC 或其他产品在日本汽车领域得到了广泛应用，通过了日本汽车客户的相关认证。在公司向国内汽车厂商包括新能源汽车厂商推广英唐微技术产品的同时，英唐微技术产品需要重新通过相关客户的认证，但基于参考英唐微技术本身已经通过的相关认证以及公司本身的客户渠道资源，将有望英唐微技术的重新认证过程缩短至行业平均水平以下。

目前公司正在与英唐微技术的技术开发及生产制造部门进行深入的对接，在对其核心的技术研发、生产制造、产品参数的信息进行了解后，将立即全面启动国内的业务推广工作，尽管英唐微技术的车载产品在日本已经具备广泛的应用，并可得到公司的客户资源支持，但仍有可能受到市场偏好不同、产品种类较为单一的影响，导致在国内市场的推广进度不达预期，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

**四、请补充说明英唐微技术所拥有的五台光刻机的品牌、型号、主要技术指标、购置时间、购置价格、账面价值及利用率等情况。**

**【回复】**

名称	品牌	型号	技术指标	购置时间	购置价格 (万日元)	账面价值	利用率
光刻机 1	尼康	NSR-2205I11D	$\leq 0.35\mu\text{m}$	2005/03/31	15533.99	因设备购超过 5	截至目前，设备

光刻机 2	NSR-2205i12D	≅0.35um	2008/03/31	19800.00	年的折旧摊销年限,账面价值已摊销完毕。	运营良好,平均产能可达40%-50%
光刻机 3	NSR-4425i	0.7um	2008/03/31	1165.00		
光刻机 4	NSR-2005i14E2	0.45um	2008/09/30	1260.00		
光刻机 5	NSR-2205i14E2	≅0.35um	2011/06/30	17950.00		

英唐微技术所拥有的 5 台光刻机全部为满足自身业务开展的需要早期对外购置的日本尼康设备,目前相关设备运行良好,其主要为 0.35μm 制程的技术指标英唐微技术现有车载芯片、OEIC、LCD、光学传感器产品的生产需要,也满足英唐微技术对 SIC-SBD、拟拓展的其他三代半导体功率器件及多数模拟芯片的生产需要,但英唐微技术本身不涉及光刻机设备的研发制造业务,请投资者注意投资风险,谨慎决策。

五、你公司披露的《2020 年第三季度报告》显示,公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非后净利润”)为-23,942.51 万元,同比下滑 282.98%。请你公司补充说明前三季度扣非后净利润大幅下滑的具体原因,公司生产经营的内外部环境及基本面是否发生重大不利变化,并充分提示风险。

回复:

1、公司前三季度扣非后净利润大幅下滑的原因:

(1) 营业收入同比下降

公司业务主要以电子元器件分销业务为主。受全球经济走势疲软、中美贸易摩擦等不利因素的叠加影响,电子分销行业部分下游客户去库存、谨慎采购的态势明显。受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司及上下游企业复工时间普遍延迟,公司各业务模块均受到不同程度的影响。且近年来公司为实现分销业务板块的集聚和专业化,剥离了部分资产。在此背景之下,公司加大了对处于较快发展进程中的云服务、5G 等市场客户的拓展力度,并对原有业务进行优化,使得公司整体营业收入较去年同期基本持平,仅下降 2.14%。

公司 2019 年前三季度、2020 年前三季度营业收入如下:

单位:万元



项目	2020年前三季度		2019年前三季度		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
电子智能控制	15,297.15	1.68%	13,149.26	1.41%	16.33%
电子分销	895,678.40	98.22%	916,150.97	98.31%	-2.23%
软件及其他	928.99	0.10%	2,580.10	0.28%	-63.99%
合计	911,904.54	100%	931,880.32	100%	-2.14%

(2) 毛利率同比下降

2020年前三季度，材料成本上升，电子智能控制业务毛利率同比下降8.32%。

公司电子元器件产品主要分为主动电子元器件和被动电子元器件。2020年初，公司主动电子元器件市场价格上涨，由于疫情导致资金、人员及物流供应迟滞，无法按照预定计划完成先期产品采购及备货，导致产品毛利率低于正常水平；而2019年初，主动电子元器件采购成本下降，毛利率高于以往水平。且2020年前三季度毛利率较低的主动电子元器件营业收入在电子分销业务中占比较上年同期提高，从而使得2020年前三季度电子分销业务毛利率较上年同期下降2.72%。

主动电子元器件、被动电子元器件在电子分销业务中的占比情况：

单位：万元

项目	2020年前三季度	占比	2019年前三季度	占比
主动电子元器件	579,250.08	64.67%	471,237.43	51.44%
被动电子元器件	316,428.32	35.33%	444,913.54	48.56%
合计	895,678.40	100.00%	916,150.97	100.00%

2020年前三季度，电子智能控制业务和电子分销业务毛利率同比下降，使得综合毛利率同比降低2.71%。

2019年前三季度、2020年前三季度，毛利率情况：

产品	2020年前三季度	2019年前三季度	增减幅度
电子智能控制	17.82%	26.14%	-8.32%
电子分销	5.06%	7.78%	-2.72%
其中：主动电子元器件	4.01%	6.02%	-2.01%
综合毛利率	5.34%	8.05%	-2.71%

2020年前三季度营业收入、综合毛利率同比下降，导致毛利同比减少26,303.07万元，归母净利润减少12,722.16万元。

2019年前三季度、2020年前三季度，毛利情况：

单位：万元

产品	2020年前三季度	2019年前三季度	增减变化
电子智能控制	2,726.36	3,436.73	-710.37
电子分销	45,295.77	71,252.60	-25,956.83
软件及其他	688.63	324.50	364.13
综合毛利	48,710.76	75,013.83	-26,303.07

(3) 信用减值损失、资产减值损失同比大幅增加

单位：万元

信用减值损失	2020年前三季度	2019年前三季度	增减变动
应收账款坏账准备	-5,340.52	292.02	-5,632.54
其他应收款坏账准备	-1,748.10	-192.35	-1,555.75
应收款项融资坏账准备	5.52		5.52
合计	-7,083.10	99.67	-7,182.77

信用减值损失同比增加 7,182.77 万元，其中应收账款坏账准备增加 5,632.54 万元，其他应收款坏账准备增加 1,555.75 万元。应收账款坏账准备增加主要是单项计提坏账准备的应收账款增加，其他应收款坏账准备增加，主要是应收前三季度剥离子公司的股权转让款计提坏账准备，和对剥离子公司欠公司款项计提坏账准备。

单位：万元

资产减值损失	2020年前三季度	2019年前三季度	增减变动
存货跌价准备	-6,388.82	-3,354.23	-3,034.60
固定资产减值准备	-2,437.83		-2,437.83
无形资产减值准备	-7,077.65		-7,077.65
商誉减值准备	-3,329.20		-3,329.20
其他	-1,500.00		-1,500.00
合计	-20,733.50	-3,354.23	-17,379.27

资产减值损失同比增加 17,379.27 万元，其中：

①存货跌价准备增加 3,034.60 万元，主要是因为自新冠疫情爆发以来，虽

然国内疫情得到控制，但海外疫情持续加重，印度、南非等地尤为严重。部分存货客户终端在印度、南非等地，终端客户位于此地区的相关交易受到严重影响，因此类电子产品更新换代速度较快，此前为该地区客户储备的库存，因版本问题无法通过其他方式实现销售，为谨慎起见，对相关库存全额计提了存货跌价准备。

②固定资产减值准备增加 2,437.83 万元，公司子公司惠州市英唐光电科技有限公司因持续亏损，拟进行清算处理，英唐光电目前已停产，固定资产已闲置，经管理层批准，高于市场价的部分全部计提减值。

③无形资产减值准备增加 7,077.65 万元，截止报告期末，收购柏建事业部 40%收益权形成的无形资产原账面净值 9,281.12 万元，因柏建事业部代理的主要产品线为美国原厂生产，受新冠疫情和中美贸易战影响，业绩持续下滑，盈利能力受到较大影响，报告期末，对柏建事业部收益权进行减值测试。经管理层批准，根据减值测试结果计提减值准备。

④商誉减值准备增加 3,329.20 万元，公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。根据测试结果确定与深圳市优软科技有限公司资产组相关的商誉发生了减值，金额为人民币 5,917.28 万元。2019 年末已计提 2,588.08 万元，2020 年当期计提 3,329.20 万元。

⑤其他增加 1,500.00 万元，为公司子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司对深圳前海智网通信科技有限公司的投资款，深圳华商龙持股 10%，国家企业信用信息公示系统显示，2020 年 9 月，深圳前海智网未按期公示 2019 年年报被列入经营异常名录，据了解，该公司已无经营，无法向深圳华商龙提供财务数据，经公司管理层评估，全部计提减值。

信用减值损失和资产减值损失增加，导致归母净利润减少 24,703.00 万元。

综上，2020 年前三季度扣非后归母净利润-23,942.51 万元，剔除营业收入同比减少和毛利率下降、信用减值损失和资产减值损失增加的对归母净利润的影响，扣非后归母净利润 13,482.65 万元，与上年同期扣非后归母净利润 13,084.69 万元相近。

单位：万元

项目	金额
2020 年前三季度扣非后归母净利润	-23,942.51
营业收入减少和毛利率下降影响归母净利润	12,722.16
信用减值损失和资产减值损失影响归母净利润	24,703.00
合计	13,482.65

因新型冠状病毒肺炎疫情对公司的影响逐步减弱,同时公司出于优化调整整体架构的考虑,为提升管理效率,实现分销业务板块的集聚和专业化,近年来通过资产剥离,对相关业务板块进行“瘦身减负”,摆脱非核心业务对公司业绩的拖累,调动公司资源聚焦主要的优势业务板块。公司已剥离或正在进行剥离的相关资产后续不再纳入公司合并报表范围,未来将不会对公司业绩产生影响,短期内对公司产生的不利影响逐渐消除。故公司生产经营的内外部环境及基本面未发生重大不利变化。

## 2、风险提示

(1) 随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延,对 2020 年全球 IC 产业链,国内电子产品制造客户均带来不同程度的影响,尽管国内疫情受到控制,但国外疫情还在持续,尤其随着近期疫情反弹迹象的出现,抗疫不确定因素增大。公司作为电子元器件产业链中间环节中的一员,若下游行业需求因疫情反弹受到较大程度的抑制,将对公司销售造成一定影响。

(2) 公司目前已完成对联合创泰的重大资产出售,其所涉及的营业收入占公司营业收入的比重较大,拥有的海力士、联发科等代理产品线资源也从公司剥离出去,公司存在主营业务规模下降的风险;同时,短期内公司主营业务仍以电子元器件分销为主,并逐步向上游半导体产业设计、研发和生产方向拓展,如果公司在未来不能迅速完成业务转型,恢复英唐微技术的盈利能力,公司经营业绩将可能存在不及预期的风险。

六、根据你公司已披露的公告,公司控股股东胡庆周所持公司股票的质押比例为 96.47%,处于逾期状态的质押股份占其所持公司股份的 22.87%。此外,胡庆周与深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)前期签订了表决权委托相关协议,在协议约定期限内表决权委托事项未完成,但双方一直未就后

续安排达成一致。请补充说明逾期质押和表决权委托事项的最新进展，胡庆周所持股份是否存在被强制平仓或司法处置的风险，胡庆周与赛格集团之间是否存在潜在纠纷，相关事项对公司控制权稳定性的影响，并充分提示风险。

### 【回复】

#### 1. 关于公司控股股东胡庆周先生逾期质押的最新进展及风险提示

截至本回复函出具之日，公司控股股东胡庆周先生质押股份总数 205,516,563 股，其中质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的 48,715,063 股股份处于逾期状态，逾期股份涉及融资本金为 0.23 亿元。

一直以来，胡庆周先生持续通过老股转让、债务重组等方式降低质押股份的逾期风险，已取得较大进展，分别于 2020 年 6 月 4 日、9 月 4 日及 9 月 30 日，对其逾期质押股票进行了解质押暨再质押，将其逾期股票进行置换质押，当前逾期质押股份数已较 2019 年 10 月时减少 151,604,386 股，累计解除逾期状态质押股份比例达 75.68%。

目前，胡庆周先生与长江资管正在就解决剩余质押股份事项的方案积极协商并逐步落实，虽已取得较大进展，但在所有逾期股份质押风险解除前，不排除长江资管通过集中竞价、大宗交易以及其他方式强制减持胡庆周先生持有的本公司股份的可能。

胡庆周先生承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。请投资者注意投资风险，谨慎决策。

#### 2. 公司控股股东胡庆周先生表决权委托事项的最新进展及风险提示

2020 年 9 月 10 日，公司收到并披露了公司股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）的《简式权益变动报告书》，赛格集团于 2020 年 9 月 8 日以大宗交易方式减持英唐智控股份 1,800 万股，占英唐智控总股本的 1.68%，持有公司股份的比例由 5.23% 降至 3.54%。赛格集团该减持行为未按照《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，在其持股比例减少至 5% 时停止卖出公司股票，违反了《创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条和第 2.3.1 条的规定，并于 2020 年 9 月 16 日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市赛格集团有限公司的监管函》（创业板监管函〔2020〕第 152 号）。

截止 2020 年 10 月 23 日，在前次违规减持基础上，赛格集团持续减持了公

公司股份 1408.52 万股（其中 1069.52 万股通过集中竞价方式减持），持有比例由 3.54% 进一步下降至 2.23%。在一个半月内累计减持公司股份约 3%，占其原本持有公司股份的 57.40%。

据公司与公司控股股东胡庆周先生核实，胡庆周先生表示，对作为公司持股 5% 以上股东、拟控股公司的战略投资者赛格集团发生的前述违规减持及多次快速大批量减持公司股票，并对公司及中小股东造成不良影响的行为表示遗憾。合格的上市公司控股股东，应以维护上市公司长远发展及广大投资者利益为己任，胡庆周先生及公司管理层均认为赛格集团并不符合这一点。鉴于上述情况，胡庆周先生表示双方继续实施表决权委托及提议改组董事会的可能性极小，并不排除通过任何包括法律程序在内的适当方式妥善处理表决权委托等后续事项。

截至本回复函出具之日，双方尚未就上述事项的后续解决方案达成一致，但鉴于上述情况，继续实施表决权委托及提议改组董事会的可能性极小，公司实际控制人将维持不变，仍为胡庆周先生，对公司未来生产经营不会产生影响。公司将与双方保持沟通，对该事项的后续进展及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险，谨慎决策。

**七、请结合前述回复说明你公司及相关人员在接受媒体采访和互动易回复中是否客观、真实、准确、完整、公平地介绍公司业务实际情况，是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形，并结合战略转型的进展、公司及英唐微技术业绩、控股股东质押情况等充分提示未来发展所面临的风险。**

#### **【回复】**

**1. 说明公司及相关人员在接受媒体采访和互动易回复中是否客观、真实、准确、完整、公平地介绍公司业务实际情况，是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形**

自 2019 年以来，公司便确认了向上游半导体芯片领域转型升级的战略布局，为落实相关的战略布局，公司先后完成了对原有分销业务体系的优化整合，并于 2020 年年初启动了收购半导体芯片设计公司先锋微技术及参股对 SIC 产品早有布局的上海芯石的投资事项，随后为改善公司资产结构、回笼发展所需资金，出售了分销资产联合创泰。截止目前，公司已经完成了对先锋微技术（英唐微技术）的收购，后续将继续完成对上海芯石的参股及对英唐微技术的产线改造事项。上

述事项均为公司布局半导体芯片领域的技术研发、生产制造及产品销售的全产业链条过程的逐步实施落地。公司对互动易的回复及接受媒体采访，是公司在完成英唐微技术收购这一阶段性成果后对公司已取得成果和未来中长期发展规划的介绍总结，有利于投资者全盘了解公司规划、坚定投资者信心。

除此之外，公司最早自 2020 年 3 月 4 日披露的《关于签署〈合作协议〉的公告》中，即对外披露了公司拟参股上海芯石、设立芯片制造公司，涉足碳化硅、功率半导体设计及制造领域。其后持续多次通过投资者调研、问询回复、定期报告、交易进展、互动易回答对外披露了公司在碳化硅领域的规划，即通过参股上海芯石以及设立新公司切入功率半导体尤其是碳化硅功率半导体芯片市场，通过上海芯石提供设计、新设立公司配套生产，建立起围绕硅基、碳化硅为基础的模拟电路、大功率器件等半导体芯片设计及生产制造的完整产业链条。2020 年 10 月 16 日，公司也在《关于先锋微技术 100%股权交割完成的公告》中披露了公司对英唐微技术在产品、生产线、平台以及公司自身未来发展目标的规划。

综上所述，公司在接受媒体采访和互动易的相关回复上是按照公司实际情况，真实、客观、准确、完整、公平的披露了投资者调研情况及公司经营情况，并严格遵守信息披露公平性原则，不存在误导性陈述，其采访和回复内容是基于公司长期连续的对外披露结果所做出的，不存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形。

今后，我们在互动易与投资者交流方面，将进一步加强学习，努力提升业务能力，采用更加通俗易懂、更加客观谨慎的语言回复投资者。同时也敬请大投资者谨慎决策，理性投资。

## **2. 结合战略转型的进展、公司及英唐微技术业绩、控股股东质押情况等充分提示未来发展所面临的风险**

为优化公司资产结构，改善财务状况，提升抗风险能力和持续经营能力，抓住国内半导体产业发展机遇当前，公司确立了向半导体芯片设计研发领域延伸的战略发展方向。截至本回复函出具日，公司已完成了英唐微技术 100%股权的交割，并即将参股上海芯石，围绕第三代半导体打造从设计、制造到销售的全产业链条。

目前正处于公司战略升级转型的关键时期，受行业、技术及政策等因素影响，

公司的转型升级还存在一定不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎决策，具体如下：

(1) 公司已经确定了向半导体芯片领域转型的方向，当前主要业务贡献仍来自于电子元器件分销业务，公司当前进入半导体芯片领域的研发团队及技术储备主要依靠收购的英唐微技术和即将参股的上海芯石，公司对英唐微技术的产品线改造还在逐步落实过程中，且其尚未恢复盈利，存在未来经营业绩及改造进度不及预期的风险；参股上海芯石，公司尚未与交易对手方签署正式协议，最终参股比例及交易价格等交易事项还未最终确定，存在不确定性；

(2) 目前国内碳化硅市场仍在逐步发展过程中，整体市场规模并不大，且产业链各环节所需原材料仍然对国外依赖性较高；国内半导体企业在产能规模、解决方案及品牌信任度等方面，与国际企业相比存在着差距。公司开发的碳化硅器件产品大规模商业化何时启动及市场需求大小、产线改造完成时间尚存在不确定性，因此公司在该领域的未来发展存在一定的不确定性；

(3) 英唐微技术所拥有的 5 台光刻机，是其为满足自身业务开展的需要于早期对外购置的日本尼康设备，其主要为 0.35 $\mu$ m 制程的技术指标满足英唐微技术现有或规划产品的需要，英唐微技术本身不涉及光刻机设备的研发制造业务；

(4) 在电子分销业务方面，随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延，对 2020 年全球 IC 产业链，国内电子产品制造客户均带来不同程度的影响，尽管国内疫情受到控制，但国外疫情还在持续，尤其随着近期疫情反弹迹象的出现，抗疫不确定因素增大。公司作为电子元器件产业链中间环节中的一员，若下游行业需求因疫情反弹受到较大程度的抑制，将对公司销售造成一定影响；

(5) 公司 2020 年前三季度扣非后净利润为-23,942.51 万元，同比下降 282.98%。公司于 2020 年 9 月完成了对联合创泰 100%股权的出售，其营业收入占公司营业收入的比重较大，公司短期内营业收入将出现较大幅度的下降，联合创泰剥离后，其拥有的海力士、联发科等代理产品线资源也将公司剥离；

(6) 公司控股股东胡庆周先生目前质押股份总数 205,516,563 股，其中 48,715,063 股股份处于逾期状态；其于 2020 年 8 月 21 日披露了股票减持计划，详见《关于公司控股股东股份减持预披露的公告》（公告编号：2020-093），胡庆周先生为偿还质押贷款，计划自 2020 年 9 月 14 日至 2021 年 3 月 14 日期间以集



中竞价交易、大宗交易或协议转让的方式减持本公司股份，减持总数不超过 53,260,680 股，占本公司总股本比例 4.98%；

据公司与胡庆周先生核实，为提升公司资信水平、营造良好的融资环境以满足公司的融资需求，胡庆周先生计划通过转让股份的方式筹集资金偿还质押贷款，降低其个人股票质押率，因此胡庆周先生在未来 3 个月内有计划在前述减持计划的范围内实施减持计划，胡庆周先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017 年修订）》等相关法律法规要求实施，并及时通知公司并披露相关信息。

（7）在表决权委托方面，截至本公告出具之日，控股股东胡庆周先生与赛格集团尚未就表决权委托及提议改选董事会相关事项的后续解决方案达成一致，但继续实施表决权委托及提议改组董事会的可能性极小，公司实际控制人将维持不变，仍为胡庆周先生，对公司未来生产经营不会产生影响。公司将与双方保持沟通，对该事项的后续进展及时履行信息披露义务；

八、请补充说明你公司控股股东、实际控制人、董监高人员、持股 5%以上股东最近 1 个月买卖公司股票的情况，未来 3 个月内是否存在减持计划，是否存在违规买卖公司股票的情形，公司是否存在利用媒体采访、互动易回复等影响股票交易以配合股东减持的情形。

#### 【回复】

1. 公司控股股东、实际控制人、董监高人员、持股 5%以上股东最近 1 个月买卖公司股票的情况，是否存在违规买卖公司股票的情形

根据《关于就〈深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则〉有关事项答投资者问答（二）》（2018.01.12），持股 5%以上的股东依据《实施细则》通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持股份至低于 5%，自持股比例减持至低于 5%之日起 90 个自然日内，通过集中竞价交易、大宗交易继续减持的，仍应当遵守《实施细则》有关持股 5%以上股东减持的

规定。

公司于 2020 年 9 月 23 日收到并披露了公司股东赛格集团于 2020 年 10 月

23日至2021年1月23日期间拟减持本公司股份的减持计划，赛格集团将择机以集中竞价交易的方式减持本公司股份，减持总数不超过10,695,264股，占本公司总股本比例1%。2020年10月23日，赛格集团通过集中竞价方式累计减持公司股份10,695,200股，占本公司总股本比例1%，其前次减持计划实施完毕，具体情况详见公司在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于公司股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2020-103）、《关于公司股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2020-130）。除此之外，赛格集团于2020年10月12日通过大宗交易减持公司股份339万股。

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董监高人员、持股5%以上股东最近1个月不存在买卖公司股票的情形，亦不存在违规买卖公司股票的情形。

## 2. 未来3个月内是否存在减持计划

公司于2020年8月21日披露了《关于公司控股股东股份减持预披露的公告》（公告编号：2020-093），持有本公司股份213,042,719股（占本公司总股本比例19.92%）的控股股东胡庆周先生计划自2020年9月14日至2021年3月14日期间以集中竞价交易、大宗交易或协议转让的方式减持本公司股份，减持总数不超过53,260,680股，占本公司总股本比例4.98%。

据公司与胡庆周先生核实，为提升公司资信水平、营造良好的融资环境以满足公司的融资需求，胡庆周先生计划通过转让股份的方式筹集资金偿还质押贷款，降低其个人股票质押率，因此胡庆周先生在未来3个月内有计划在前述减持计划的范围内实施减持计划，胡庆周先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》等相关法律法规要求，及时通知公司并披露相关信息。除此之外，公司其他董监高人员在未来三个月不存在减持计划，请投资者注意投资风险，谨慎决策。

## 3. 公司是否存在利用媒体采访、互动易回复等影响股票交易以配合股东减持的情形

经公司自查与核实，公司在接受媒体采访、回复互动易投资者相关提问时，皆以多数投资者及中小股东在互动易等公开渠道对公司业务情况提出的问题为基础，结合市场行业现状及公司实际情况，对其进行回复，不存在主动迎合市场热点的情形。公司按照相关规定严格遵守信息披露公平性原则，及时披露投资者

调研情况及公司经营情况，且相关内容与公司依法披露的信息并无冲突，不存利用媒体采访、互动易回复影响股票交易以配合股东减持的情形。

九、你认为需要说明的其他事项。

**【回复】**

无其他需说明事项。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2020年10月27日